2026年11月13日

各　　位

会 社 名　内 外 テ ッ ク 株 式 会 社
代表者名　代表取締役社長　岩井田 克郎
（スタンダード・コード３３７４）
問合せ先　専務取締役　　佐々木　政彦
電　　話　０３－５４３３－１１２３（代表）

業績予想の修正および配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、2026年８月７日および2026年10月14日に公表しました2027年３月期（2026年４月１日～2027年３月31日）の連結業績予想および配当予想を修正することとしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．業績予想の修正について

2027年３月期通期連結業績予想数値の修正（2026年４月１日～2027年３月31日）

	売　上　高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益	１株当たり当期純利益
前回発表予想（Ａ） （2026年８月７日発表）	百万円 50,900	百万円 2,560	百万円 2,540	百万円 1,680	円 銭 479.71
今回修正予想（Ｂ）	52,100	2,660	2,650	1,780	254.13
増　減　額（Ｂ－Ａ）	1,200	100	110	100	－
増　減　率　　（％）	2.4	3.9	4.3	6.0	－
（ご参考）前期実績 （2026年３月期）	32,614	1,402	1,389	971	277.74

（注）今回修正予想の１株当たり当期純利益は、2026年12月１日予定の株式分割（１株につき２株の割合）を考慮した金額を記載しております。

２．業績予想の修正理由

2027年３月期の連結業績予想につきましては、ＡＩ需要の拡大を背景とする半導体メーカーによるＡＩ関連分野への設備投資が引き続き堅調に推移し、半導体製造装置の需要を牽引していることや、経済安全保障の観点から半導体の国内生産基盤の強化に向けた政策的支援が継続しており、半導体製造拠点の新増設に向けた取り組みについて中長期的に堅調な成長が見込まれること、またこれらの環境のもと、当社グループの販売事業・受託製造事業が共に計画を上回る水準で推移したこと、および第３四半期以降におきましても、原材料価格や人件費の上昇といったコスト面の不安定要素はあるものの、ＡＩ関連を中心とした半導体需要の拡大基調は継続し、当社グループの受注高も堅調な推移が見込まれることなどから、通期の売上高および各段階利益をそれぞれ上記のとおり修正することといたしました。

３．配当予想の修正について

	年間配当金（円）		
基準日	第２四半期末	期末	合計
前回発表予想 （2026年10月14日）		72円00銭	72円00銭
今回修正予想		77円00銭	77円00銭
当期実績	０円00銭		
前期実績 （2026年３月期）	０円00銭	105円00銭	105円00銭

（注）前回発表予想および今回修正予想の年間配当金は、2026年12月１日予定の株式分割（１株につき２株の割合）を考慮した金額を記載しております。

４．配当予想の修正理由

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要政策の一つとして位置付けております。

当社の配当方針は、経営成績、財務状況及び今後の事業展開を勘案し、必要な内部留保を確保しつつ、連結配当性向30%以上かつ連結株主資本配当率（ＤＯＥ）３%以上を目標とし、業績に応じた配当を継続していくこととしています。

この基本方針のもと2027年３月期の１株当たりの期末配当を144円（連結配当性向30.0% 連結株主資本配当率3.7%）と予想し2026年８月７日に公表し、2026年10月14日に公表した株式分割に伴い、分割比率に合わせた72円への修正を公表しましたが、上記１．２．に記載のとおり2027年３月期通期連結業績予想について上方修正したことを踏まえ、１株当たりの期末配当予想を77円（連結配当性向30.3% 連結株主資本配当率4.0%）に修正することといたしました。

（注）本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社グループが現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は今後の様々な要因によって異なる可能性があります。

以　上